



TSMC (TSM.US)

AI 수요 강세 지속, Consumer 시장도 반등

- 3Q25CY 실적 서프라이즈 기록, 환율 상승 효과 때문
- 4Q25CY 가이드언스 시장 기대치 상회. 환율 효과 및 강한 선단 공정 수요 영향
- 소버린 AI 효과로 AI 성장률의 중장기 전망치 상향 조정 가능성 언급

3Q25CY 실적, 서프라이즈 기록

TSMC의 3Q25CY 실적이 매출액 \$33.10B(+10%QoQ, +41%YoY)와 영업이익 \$16.74B(+11%QoQ, +50%YoY)를 기록하며, 시장 컨센서스(Bloomberg: 매출액 \$31.45B, 영업이익 \$14.91)를 상회했다. GPm도 59.5%를 기록하며 회사 측 가이드언스 및 컨센서스를 상회했는데, 대부분 서프라이즈를 환율 상승 효과 때문이다. 긍정적인 점은 Smartphone과 IoT, Automotive 부문의 매출액이 바닥을 통과하며, 전 분기 대비 +18~20%QoQ 수준 상승했다는 점이다. 이는 여전히 강한 AI 수요와 맞물리며 TSMC의 중장기 실적 성장에 대한 가시성을 더욱 높일 것으로 판단하기 때문이다.

4Q25CY 실적 가이드언스, 시장 컨센서스 상회

4Q25CY 실적 가이드언스는 매출액 \$32.2~33.4B(-3%~+1%QoQ, +20~24%YoY)와 영업이익 \$15.78~17.03B(-6%~+2%QoQ, +20~29%YoY)로 제시되며, 시장 컨센서스(Bloomberg: 매출액 \$31.23B, 영업이익 \$14.68B)를 상회했다. TSMC 측은 선단 공정의 수요가 강하고, 분기 후반에 N2 공정의 양산이 본격화되며, 실적 성장을 이어갈 것이라고 언급했다.

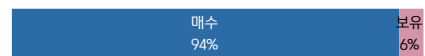
환율 상승이 해외 공장 가동에 GPm 희석 효과 상쇄 중

이번 컨퍼런스 콜에서 TSMC는 2025년 CapEx 전망치를 기존 US\$38~42B에서 US\$40~42B로 소폭 상향했으며, 2026년 CapEx에 대해서도 긍정적인 시각을 보였다. 또한 소버린 AI가 AI 수요를 가속화하고 있어, 기존에 제시했던 +44~46% CAGR이라는 AI 시장 성장률 가이드언스를 상향 조정할 가능성이 있다는 점도 언급했다(정확한 수치는 내년 초에 제시할 예정). 현재는 고객들로부터 강한 수요를 확인하고 있고, 또한 TSMC의 생산능력 확정에 대한 요청을 받고 있는 상황이다. 관세 불확실성에 따른 실적 변동 가능성이 있지만, 실적 성장의 우상향 흐름은 당분간 유효할 것으로 판단된다.

▶ 현재주가 / 목표주가 컨센서스

현재주가('25.10.17): \$295.08
 목표주가 컨센서스: \$313.01

▶ 투자 의견 컨센서스



Stock Data

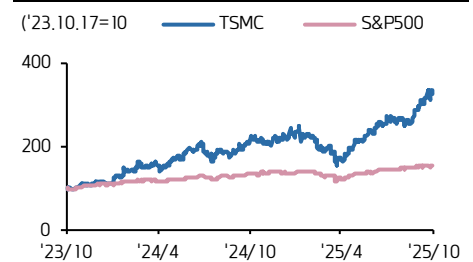
산업분류	반도체 & 반도체 장비
S&P 500 (10/17)	6,664.01
현재주가/목표주가	295.08 / 313.01
52주 최고/최저 (\$)	311.37 / 134.25
시가총액 (백만\$)	1,257,796
유통주식 수 (백만)	5,184
일평균거래량 (3M)	12,425,504

Earnings & Valuation

(백만 \$)	FY23	FY24	FY25E	FY26E
매출액	69,405	90,083	122,621	144,301
영업이익	29,585	41,148	54,829	63,083
OPM(%)	42.6	45.7	44.7	43.7
순이익	26,921	36,517	51,455	59,865
EPS	5.2	7.0	10.1	12.1
증가율(%)	-21.3	35.6	43.3	19.8
PER(배)	20.2	27.8	29.7	24.8
PBR(배)	4.4	6.5	12.2	9.8
ROE(%)	26.4	30.0	31.7	29.1
배당수익률(%)	2.0	1.5	0.9	1.1

Performance & Price Trend

주가수익률 (%)	YTD	1M	6M	12M
절대	51.8	14.4	97.7	59.9
S&P Index	13.4	0.8	23.6	14.7



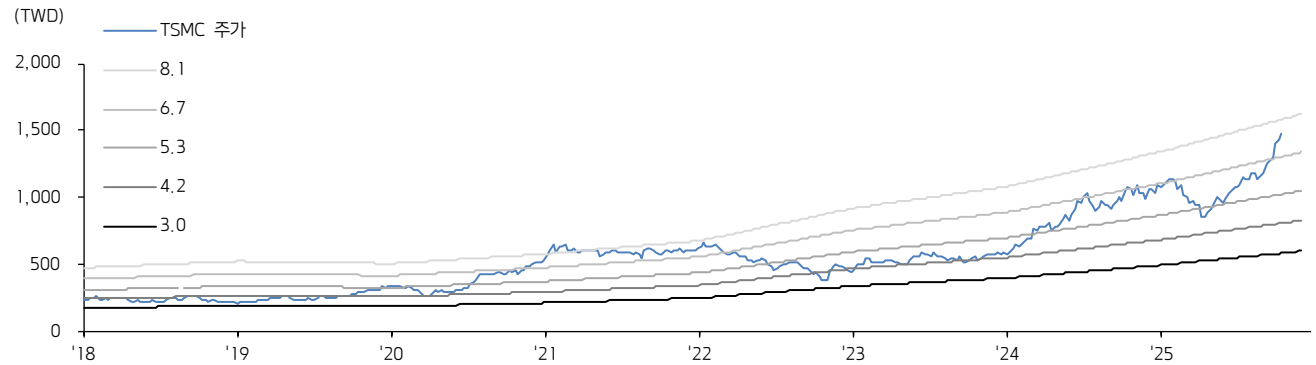
자료: 데이터 스트림 컨센서스, 키움증권 리서치센터

TSMC 분기 실적 및 가이드스 vs. 시장 컨센서스 (단위: 백만달러)

	3Q25			4Q25E		
	발표치	컨센서스	차이	가이드스	컨센서스	차이
매출액	33,097	31,453	5%	32,800	31,234	5%
매출총이익	19,663	17,961	9%	19,686	17,766	11%
매출총이익률	59%	57%		60%	57%	
영업이익	16,740	14,906	12%	16,406	14,703	12%
영업이익률	51%	47%		50%	47%	
당기순이익	15,111	13,232	14%	-	12,856	N/A
당기순이익률	46%	42%		-	41%	
EPS	0.58	0.51	14%	-	0.50	N/A

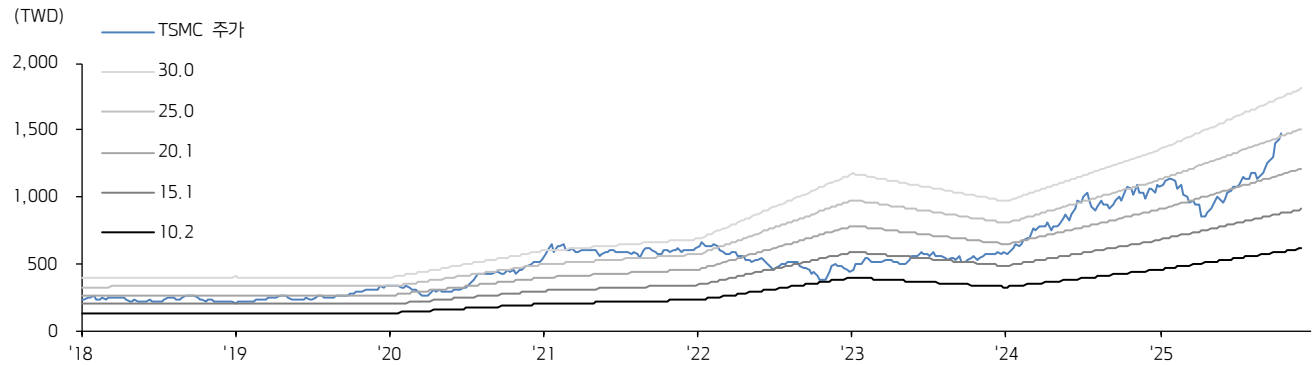
주: 컨센서스는 2025/10/15 Bloomberg 기준. 가이드스는 중간값 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

TSMC 12개월 Trailing P/B Chart



주: 10/16 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

TSMC 12개월 Trailing P/E Chart



주: 10/16 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

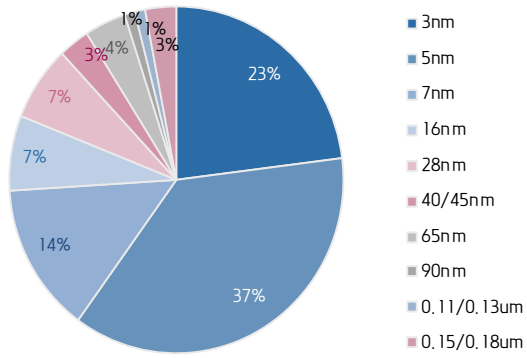
TSMC 실적 추이 및 전망 (단위: 백만달러)

	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25E	2024	2025E	2026E
매출액	18,846	20,817	23,520	26,836	25,512	30,318	33,097	32,327	90,020	121,230	147,006
%QoQ/%YoY	-4%	10%	13%	14%	-5%	19%	10%	-2%	30%	35%	21%
HPC	8,738	10,861	12,053	14,258	14,993	18,219	18,876	19,209	45,910	71,297	88,025
%QoQ/%YoY	4%	24%	11%	18%	5%	22%	4%	2%	53%	55%	23%
Smartphone	7,156	6,879	7,972	9,272	7,101	8,116	8,695	9,258	31,279	33,170	36,646
%QoQ/%YoY	-15%	-4%	16%	16%	-23%	14%	7%	6%	20%	6%	10%
Internet of Things	1,123	1,154	1,556	1,316	1,177	1,438	1,583	1,364	5,150	5,562	6,479
%QoQ/%YoY	7%	3%	35%	-15%	-11%	22%	10%	-14%	-1%	8%	16%
Automotive	1,022	1,043	1,104	1,167	1,308	1,397	1,199	1,105	4,337	5,010	5,686
%QoQ/%YoY	2%	2%	6%	6%	12%	7%	-14%	-8%	1%	16%	13%
DCE	373	436	353	331	351	487	293	289	1,493	1,420	1,476
%QoQ/%YoY	35%	17%	-19%	-6%	6%	39%	-40%	-1%	-1%	-5%	4%
매출액 비중(Technology)											
3nm	9%	15%	20%	26%	22%	24%	23%	29%	18%	25%	28%
5nm	37%	35%	32%	34%	36%	36%	37%	33%	34%	34%	28%
7nm	19%	17%	17%	14%	15%	14%	14%	13%	17%	13%	11%
16nm	9%	9%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	8%	7%	7%
28nm	8%	8%	7%	6%	7%	7%	7%	6%	7%	7%	6%
Others	14%	13%	18%	2%	18%	17%	12%	19%	15%	18%	19%
매출원가	8,845	9,748	9,918	11,003	10,513	12,546	13,410	13,585	39,514	50,055	62,557
매출원가율	47%	47%	42%	41%	41%	41%	41%	42%	44%	41%	43%
매출총이익	10,001	11,069	13,602	15,833	14,998	17,772	19,663	18,742	50,506	71,175	84,449
판매비와 관리비	613	687	814	888	871	748	803	998	3,002	3,420	4,224
영업이익	7,919	8,857	11,169	13,155	12,375	15,046	16,740	15,628	41,100	59,788	71,515
%QoQ/%YoY	-3%	12%	26%	18%	-6%	22%	11%	-7%	39%	45%	20%
영업이익률	42%	43%	47%	49%	49%	50%	51%	48%	46%	49%	49%
법인세차감전순이익	8,476	9,468	11,895	13,868	13,098	16,008	17,553	16,349	43,707	63,007	74,540
법인세비용	1,306	1,807	1,824	2,290	2,108	3,077	2,441	2,627	7,228	10,252	11,877
당기순이익	7,170	7,661	10,070	11,578	10,991	12,931	15,111	13,722	36,479	52,755	62,663
당기순이익률	38%	37%	43%	43%	43%	43%	46%	42%	41%	44%	43%
CapEx	5,766	6,357	6,411	11,185	10,057	9,650	9,604	11,852	29,719	41,163	44,618
%QoQ/%YoY	8%	10%	1%	74%	-10%	-4%	0%	23%	-2%	39%	8%
감가상각비	5,057	5,105	5,208	5,265	5,324	6,106	5,439	5,741	20,635	22,609	27,657
%QoQ/%YoY	7%	1%	2%	1%	1%	15%	-11%	6%	21%	10%	22%
USD/TWD	31.40	32.35	32.32	32.79	32.88	31.05	29.91		31.99		

주: 실적 전망치는 Bloomberg 컨센서스 기준 (기준일: 2025/10/16), 실적은 Non-GAAP, CY 기준 (회계 기준 결산일은 12/31일)

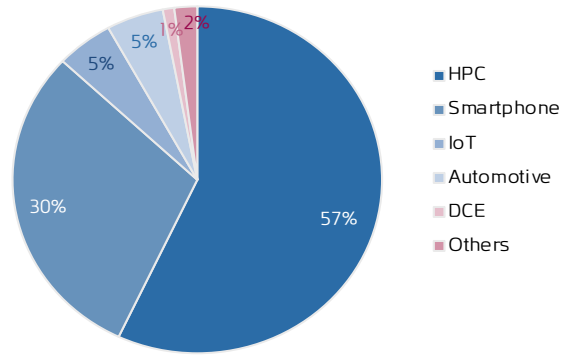
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

TSMC 3Q25 Revenue by Technology



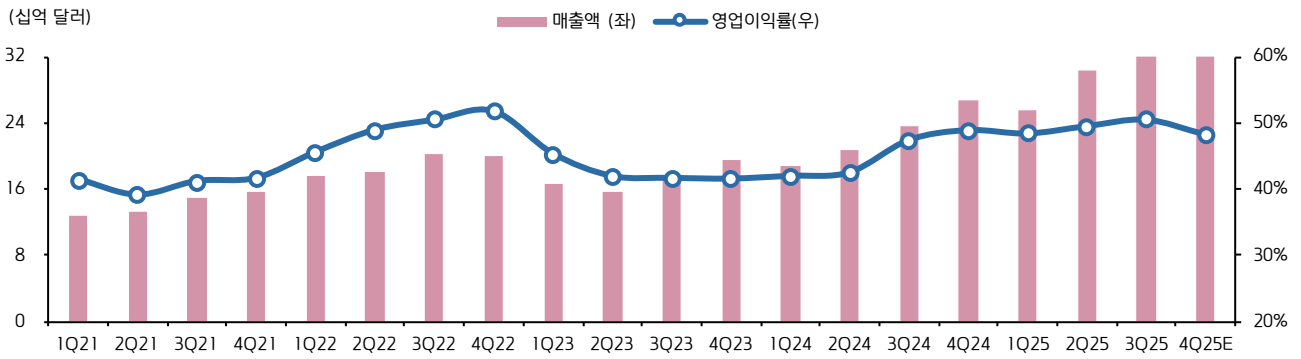
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

TSMC 3Q25 Revenue by Platform



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

TSMC 매출액 및 영업이익률 추이



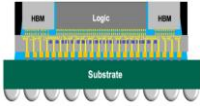
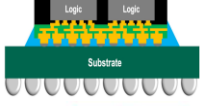
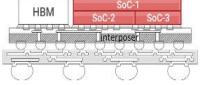
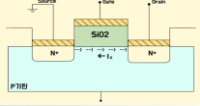
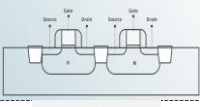

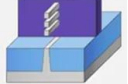
주: 실적 전망치는 Bloomberg 컨센서스 기준 (기준일: 2025/10/16)

자료: TSMC, 키움증권 리서치센터

글로벌 Tech 기업 추가 및 Valuation

	(십억달러, 배, %)	Mkt Cap	%CHG				P/E		P/B		EV/EBITDA		Rev		OP		EBITDA		ROE		
			1D	5D	1M	3M	6M	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E
Memory																					
Micron		227.3	5.5	5.3	27.5	74.0	192.1	18.3	11.1	3.8	2.9	9.9	6.6	43.0	57.4	13.7	24.5	23.4	33.3	20.5	26.1
Sandisk		21.1	-0.0	11.3	57.6	248.8	350.4	56.2	15.8	2.2	2.0	26.1	10.4	8.1	9.8	-1.3	1.9	0.8	2.1	-2.5	13.9
Kioxia		24.7	8.9	17.0	55.0	185.0	275.1	22.7	7.3	4.1	2.9	6.3	4.5	11.6	13.4	1.9	4.2	4.7	5.8	28.6	36.7
Seagate		48.1	3.0	2.0	7.1	53.6	210.4	23.7	18.9	308.0	29.2	17.9	13.8	9.8	11.2	2.5	3.4	2.9	3.7	-0.6	251.9
Western Digital		43.2	4.5	5.2	22.1	89.3	253.5	19.9	17.8	6.7	5.1	13.8	11.0	10.5	11.7	3.0	3.4	3.3	3.9	32.7	38.1
Nanya		9.6	10.0	4.5	29.5	120.2	195.6	790.8	11.0	1.8	1.5	19.4	5.1	2.0	3.4	-0.0	1.0	0.5	1.6	0.3	14.5
Logic																					
Intel		171.4	-0.8	-2.5	45.8	62.4	91.6	244.0	55.1	1.5	1.5	16.9	12.0	52.0	53.8	1.2	4.8	12.9	16.4	-0.6	2.1
Nvidia		4418.0	1.1	-5.6	4.0	6.1	74.0	40.5	28.7	31.5	17.9	32.9	22.8	200.0	275.0	121.3	183.5	132.3	186.5	91.8	76.2
AMD		380.7	-1.7	0.7	46.2	46.5	165.7	59.4	37.4	6.2	5.6	51.6	32.2	33.1	41.6	7.2	11.1	8.0	11.9	8.4	13.0
Broadcom		1672.4	0.8	2.6	-1.6	26.1	102.8	51.2	35.9	21.2	16.3	39.1	28.0	65.4	90.5	33.3	59.6	43.7	60.2	42.3	48.4
Marvell		76.1	-0.7	-2.7	28.1	24.5	69.9	32.2	26.5	5.2	4.8	24.8	21.2	8.0	9.3	1.9	3.4	3.1	3.6	5.3	3.6
Qualcomm		177.0	0.7	-1.0	-0.0	6.5	20.9	14.0	13.6	6.1	5.5	11.2	10.8	43.5	44.5	13.6	15.1	16.0	16.3	43.8	39.5
Arm		181.3	0.3	0.3	11.3	11.2	69.5	108.3	77.9	23.0	18.2	85.2	61.5	4.5	5.6	1.3	2.6	2.1	2.9	17.0	20.1
Skyworks		11.1	0.3	1.1	0.3	2.2	33.3	14.2	17.1	2.1	2.2	N/A	N/A	3.9	3.7	0.7	0.7	1.3	1.2	11.3	9.2
TI		159.5	0.1	-1.9	-1.2	-19.0	19.7	29.3	25.7	9.6	9.1	21.1	17.9	17.7	19.5	6.1	7.3	8.0	9.5	30.6	35.8
ADI		118.9	1.5	1.6	-1.0	0.4	37.3	29.7	24.9	3.5	3.4	20.6	18.3	11.3	12.6	3.8	5.7	6.0	6.8	9.3	11.8
NXP		54.8	0.1	-1.8	-1.6	-1.4	29.0	18.4	15.4	5.6	4.9	13.7	11.8	12.2	13.3	4.0	4.6	4.6	5.3	28.5	32.6
STMicro		26.7	1.3	2.2	7.7	-7.9	45.8	46.6	20.8	1.5	1.4	10.3	7.0	11.8	13.3	0.4	1.4	2.3	3.4	3.1	6.9
Microchip		35.3	0.2	-0.8	1.4	-12.2	72.2	58.9	28.1	5.7	5.5	30.3	18.7	4.4	5.4	0.5	1.7	1.4	2.2	7.7	18.4
On Semi		21.7	5.2	6.0	6.9	-11.0	54.7	23.1	18.1	2.8	2.6	13.6	11.9	6.0	6.3	1.1	1.4	1.6	1.8	9.2	14.8
Silicon Motion		3.1	-0.3	-1.9	2.3	29.5	131.8	27.2	19.4	3.7	3.3	19.3	13.8	0.8	1.0	0.1	0.2	0.1	0.2	12.9	17.9
Mediatek		69.5	1.1	-0.4	-11.9	-4.3	-0.7	19.9	17.5	5.4	5.0	14.7	13.1	19.1	21.3	3.6	4.1	4.4	4.8	27.0	29.5
Renesas		24.1	8.2	5.2	10.9	1.8	19.3	12.6	9.9	1.5	1.4	13.3	10.0	8.6	9.4	1.1	1.6	2.3	2.9	0.5	9.7
Novatek		8.2	1.0	-3.4	-3.2	-17.8	-16.4	15.2	13.0	3.8	3.6	9.7	8.8	3.3	3.5	0.6	0.7	0.7	0.7	24.9	28.1
Foundry																					
TSMC		1555.1	-1.6	-0.0	14.4	26.2	97.7	29.8	25.2	9.0	7.2	17.9	14.9	122.2	146.1	59.5	70.7	84.0	99.3	32.7	31.1
SMIC		92.8	-2.8	-11.5	9.2	59.6	60.7	106.8	73.7	3.5	3.3	24.6	20.8	9.3	11.0	0.8	1.2	4.5	5.4	3.3	4.5
UMC		18.7	0.1	-0.7	8.8	-0.1	8.5	20.7	17.2	0.2	0.1	N/A	N/A	7.7	8.1	1.3	1.5	3.3	3.7	9.9	11.2
GFS		19.2	-1.5	-2.1	8.0	-13.7	9.3	21.6	17.2	1.6	1.5	7.0	5.8	6.8	7.3	1.0	1.6	2.3	2.5	8.0	9.2
VIS		6.1	2.2	-2.9	8.7	6.4	11.1	22.9	22.1	2.7	2.6	10.9	10.8	1.6	1.7	0.3	0.3	0.6	0.6	12.0	12.4
Packaging																					
ASE		27.8	5.4	7.4	11.3	20.7	53.2	23.2	15.1	N/A	N/A	N/A	N/A	20.6	22.9	1.5	2.4	3.6	4.5	11.5	N/A
Amkor		7.8	0.7	2.8	16.5	48.4	95.0	27.7	20.5	1.7	1.6	6.9	5.9	6.6	7.0	0.4	0.5	1.1	1.3	6.3	8.2
Agilent		40.0	1.0	0.7	10.9	24.4	37.4	25.0	23.1	5.9	5.3	20.5	18.9	7.0	7.3	1.6	2.0	2.0	2.2	24.4	23.4
Chibbond		1.4	0.7	2.0	6.1	3.4	-1.7	13.3	13.2	0.9	0.9	5.2	5.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.2	0.2	7.4	7.3
Equipment																					
ASML		395.8	1.0	4.0	16.1	35.1	60.6	35.6	33.9	16.8	14.1	27.3	25.9	37.8	39.4	13.0	13.5	14.2	14.9	49.5	45.1
AMAT		181.4	0.1	3.4	31.2	16.9	64.8	24.7	23.3	9.3	8.4	20.5	19.3	28.0	29.7	8.3	8.8	8.8	9.3	37.4	37.0
LAM Research		179.5	-1.7	1.0	18.2	41.8	118.6	30.7	29.7	16.6	13.5	25.4	24.4	20.0	21.0	6.6	6.8	7.0	7.2	56.0	53.6
TEL		94.8	4.1	3.4	24.7	8.9	52.7	27.0	24.6	7.0	6.3	18.9	15.8	16.0	17.0	4.3	4.6	4.8	5.7	26.0	25.3
KLA		144.7	1.1	4.3	10.9	17.7	71.1	31.5	29.7	26.7	20.3	25.1	23.9	12.6	13.4	5.3	5.7	5.8	6.1	93.2	80.0
AMEC		24.1	0.1	-14.0	20.8	54.0	43.3	77.4	53.0	7.8	6.9	69.5	45.5	1.7	2.2	0.3	0.5	0.3	0.5	10.3	13.4
Naura		41.7	-0.4	-10.3	5.5	28.9	19.7	39.3	30.3	7.8	6.0	31.5	23.5	5.4	6.9	1.1	1.5	1.3	1.7	20.4	21.6
Materials																					
Linde		207.2	-2.4	-4.7	-4.9	-4.3	-3.3	26.9	24.6	5.3	5.0	17.0	16.0	33.9	35.7	10.0	10.8	13.3	14.2	19.6	20.4
Air Liquid		117.7	1.6	1.5	-0.3	0.5	-0.4	26.5	23.8	3.5	3.3	13.4	12.4	31.8	33.2	6.6	7.2	9.6	10.3	14.0	14.8
Air Products		56.3	-1.6	-3.6	-11.1	-12.4	-3.1	20.7	19.1	3.2	2.9	14.2	13.3	12.2	12.8	0.0	3.3	5.2	5.6	16.3	16.1
Merck KGaA		56.8	-4.0	-5.3	5.1	1.3	-5.7	13.4	12.5	1.5	1.4	9.3	8.6	24.7	25.6	4.5	4.9	7.0	7.3	10.8	10.6
ADEKA		2.3	0.2	-1.0	-0.6	15.8	41.7	14.2	14.9	1.1	1.1	6.1	8.0	2.8	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3	8.7	8.9
Resonac		7.2	-0.8	0.6	26.9	62.8	131.3	35.4	15.3	1.6	1.5	11.2	8.5	8.9	9.2	0.4	0.7	1.1	1.4	4.7	10.6
Siltronic		1.9	-0.1	0.5	36.5	31.3	64.7	N/A	N/A	0.9	0.9	9.5	7.1	1.5	1.7	-0.1	-0.0	0.4	0.5	-4.2	-5.1
Sumco		4.0	1.6	3.0	21.2	38.1	90.0	N/A	258.7	1.0	1.0	7.9	6.1	2.7	2.9	0.0	0.1	0.8	0.9	-0.6	0.5
Server																					
Dell		102.3	-1.6	-3.0	18.5	22.4	81.5	16.1	13.5	N/A	218.9	10.4	9.3	106.4	116.3	8.1	10.6	11.7	12.8	-334.8	202.8
HPE		29.7	-10.1	-14.3	-7.9	10.6	51.2	11.6	9.2	1.2	1.1	7.7	6.0	35.9	41.2	1.2	4.8	6.0	7.3	11.1	12.2
Lenovo		18.4	-0.9	-8.4	-3.7	13.3	42.5	14.0	11.1	2.6	2.2	5.6	4.1	75.8	81.2	2.6	3.0	3.3	4.4	23.9	23.6
Quanta		36.8	1.9	-4.7	6.8	7.6	26.7	16.2	13.7	5.2	4.6	11.9	10.4	70.4	92.8	2.8	3.3	3.2	3.8	31.0	33.6
Inspur		13.9	-0.5	-11.3	3.6	21.9	43.1	35.6	27.5												

TSMC 관련 용어

용어	이미지	설명
N7 Node		7nm급 공정으로, 18년 양산을 시작해 3Q25 기준 14%의 매출 비중을 차지
N5 Node		5nm급 공정으로, 20년 양산을 시작해 3Q25 기준 37%의 매출 비중을 차지
N3 Node		3nm급 공정으로, 22년 양산을 시작해 3Q25 기준 23%의 매출 비중을 차지
N2 Node		2nm급 최첨단 공정으로, 25년 하반기 양산 예정
N2P Node		2nm급 최첨단 공정의 업그레이드 버전으로, 26년 하반기 양산 계획
A16 Node		1.6nm급 차세대 공정으로, 26년 하반기 양산 계획
A14 Node		1.4nm급 차세대 공정으로, 28년 양산 계획
HPC (High-Performance Computing)		AI 반도체가 탑재된 슈퍼컴퓨터 및 AI 데이터센터 관련 고성능컴퓨터 사업부문
IoT (Internet of Things)		웨어러블, 스마트 홈 등 사물 인터넷 애플리케이션 관련 사업부문
DCE (Digital Consumer Electronics)		스마트TV, 셋톱박스 등 디지털 소비자 전자제품 관련 사업부문
CoWoS (Chip on Wafer on Substrate)		2개 이상의 칩을 웨이퍼 상에서 연결해 기판에 올리는 TSMC의 고급 2.5D 반도체 패키징 기술
FOWLFP (Fan-Out Wafer Level Packaging)		Fan-Out 구조를 활용해, I/O 단자 배선을 칩 밖으로 빼내어 성능과 열효율을 향상한 패키징 기술
SoIC (System on Integrated Chip)		초고밀도 수직 적층 구조를 통해 다양한 칩렛을 단일 칩으로 통합하는 패키징 기술
CPO (Co-packaged Optics)		단일 패키지 기판에 광학 소자와 실리콘을 이중 집적하여 전력 및 비용을 절감한 패키징 기술
MOSFET		반도체 기판에 Source와 Drain을 추가한 트랜지스터. 게이트의 전압을 조절해 전류를 제어
CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor)		PMOS와 NMOS가 상호보완적으로 활용되는 집적회로의 한 종류. 집적도가 높고 소모 전력이 적음
FinFET (Fin Field Effect Transistor)		게이트가 기판과 맞닿는 면이 1개인 MOSFET 대비 3면에서 채널을 형성해 소자 성능을 개선
GAA (Gate-All-Around)		채널을 게이트가 완전히 감싸는 구조로 보다 우수한 전류 제어 능력을 제공하는 구조

자료: TSMC, 삼성전자, SK하이닉스, 키움증권 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.